



# High Performance BGA Cooling Solutions w/ maxiGRIP™ Attachment

**ATS PART # ATS-53170K-C2-R0**

## Features & Benefits

- » High aspect ratio, straight fin heat sinks that are ideal for compact PCB environments
- » maxiGRIP™ attachment applies steady, even pressure to the component and does not require holes in the PCB
- » Designed specifically for BGAs and other surface mount packages
- » Meets Telcordia GR-63-Core Office Vibration; ETSI 300 019 Transportation Vibration; and MIL-STD-810 Shock Testing and Unpackaged Drop Testing standards
- » Comes preassembled with high performance, phase changing, thermal interface material



*\*Image above is for illustration purposes only.*

## Thermal Performance

### AIR VELOCITY

### THERMAL RESISTANCE

| FT/MIN | M/S | °C/W (UNDUCTED FLOW) | °C/W (DUCTED FLOW) |
|--------|-----|----------------------|--------------------|
| 200    | 1.0 | 13.1                 | 7.8                |
| 300    | 1.5 | 10.4                 |                    |
| 400    | 2.0 | 9                    |                    |
| 500    | 2.5 | 8.1                  |                    |
| 600    | 3.0 | 7.4                  |                    |
| 700    | 3.5 | 6.9                  |                    |
| 800    | 4.0 | 6.5                  |                    |

## Product Details

| DIMENSION A | DIMENSION B | DIMENSION C | DIMENSION D | INTERFACE MATERIAL  | FINISH         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|
| 17 mm       | 17 mm       | 14.5 mm     | 17 mm       | SAINT-GOBAIN C1100F | BLACK-ANODIZED |

### NOTES:

- 1) Dimension C = heat sink height from bottom of the base to the top of the fin field.
- 2) ATS-53170K-C1-R0 is a substitute item available utilizing an equivalent phase change material (Chomerics T766).
- 3) Thermal performance data are provided for reference only. Actual performance may vary by application.
- 4) ATS reserves the right to update or change its products without notice to improve the design or performance.
- 5) Optional maxiGRIP™ Installation/Removal Tool Set P/N: MGT170
- 6) Contact ATS to learn about custom options available.



**ATS** ADVANCED THERMAL SOLUTIONS, INC.  
Innovations in Thermal Management®

**For more information, to find a distributor or to place an order, visit [www.qats.com](http://www.qats.com) or call: 781.769.2800 (North America); +31 (0) 3569 84715 (Europe).**

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)